

ファイバーレーザー高速微細加工装置の紹介

H26年度電源地域対策交付金

レーザー光によるマーキング、溶接、表面処理などが高速で行えます。

本装置は、ファイバーレーザー発振器よりレーザー光を出力し、高速2Dスキャンヘッドおよび多関節ロボットの動作により加工対象物にレーザー光を照射して、主として金属表面を高エネルギー加工により、高速で精密に溶融、除去、成型する装置です。金型や機械部品、金属製品に対し0.1ミリメートルのオーダーでの溶接、切断、穴あけ、表面除去などの微細加工ができます

<主な用途>



レーザーマーカ



レーザー加工
(溶接、切断、スクライブ、穴あけ)

<主な仕様>

レーザー発振器

- ・レーザー波長：1070nm
 - ・発振形態：パルス、連続
 - ・最大定格出力：150W（パルス）250W（連続）
- スキャナ
- ・スキャンエリア：150×150mm
 - ・制御軸数：XY2軸



- ・レーザー発振器：YLR150/1500-QCW-AC
(IPGフォトニクスジャパン株)
- ・高速2Dスキャンヘッド：HS-201A (キヤノン株)
- ・多関節ロボット：AII-V20 (株ダイヘン)